

Xeon® スケーラブル・プロセッサー搭載。ハイエンドGPU搭載可能な奥行き480mm

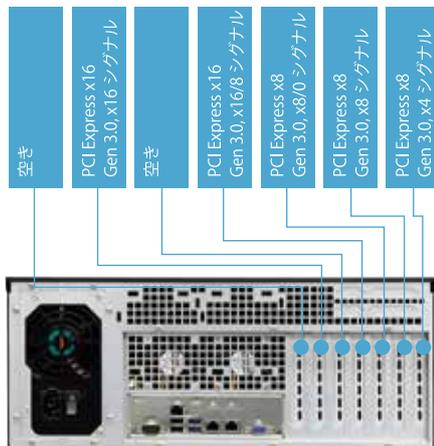
IPC-S622SPI-R4(V)



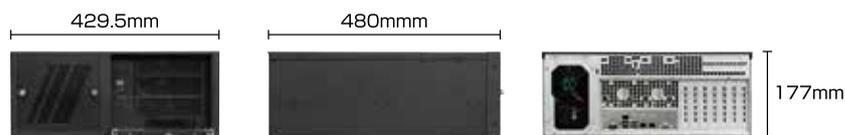
- インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー搭載
- シングルプロセッサーながら、最大20コア (40スレッド)
※インテル® Xeon® Gold 6138 プロセッサー選択時
- 最大1TBメモリー (DDR4)搭載可能
- ハイエンドGPUボードが搭載可能
- 10G BASE-T LANを2基搭載
- 最大4台の2.5インチSSD/HDDが搭載可能なリムーバブルケースを標準装備
- 筐体の縦置きも可能



■ 拡張スロット構成



■ 外観寸法図



■ I/O ポート構成



■ 製品仕様

モデル		通常モデル IPC-S622SPI-R4	GPU対応モデル(V) IPC-S622SPI-R4V
プロセッサ	種類	インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサ	
	搭載数	1	
チップセット		インテル® C622 チップセット	
メモリー	規格	DDR4 2666MHz ECC	
	最大容量	1TB	
	スロット数	8	
ストレージ	5インチベイ	3 (空き2)※標準:ストレージ×1で使用。リムーバブルケース標準装備で、最大4基の2.5インチSSD/HDDが搭載可能	
	3.5インチベイ	内部1	
	SATAコネクタ数	6 (空き5) (SATA 3.0) ※標準:ストレージ×1で使用	
グラフィックス		Aspeed AST2500 BMC	
I/O	VGA	1	
	シリアル (COM)	1	
	USB	前面 2 (USB2.0) / 背面 2 (USB3.0), 2 (USB2.0)	
	LAN	2 (10GbE)	
	IPMI	1	
拡張スロット		SLOT_7: None SLOT_6: PCI-Express x16 (x16シグナル, Gen 3.0, CPU側) SLOT_5: None SLOT_4: PCI-Express x16 (x16/8シグナル, Gen 3.0, CPU側) ※ SLOT_3: PCI-Express x8 (x8/0シグナル, Gen 3.0, CPU側) ※ ※SLOT_4でx16シグナル時は、SLOT_3は使用不可 ※SLOT_4でx8シグナル使用時、SLOT_3はx8シグナル使用可能 SLOT_2: PCI-Express x8 (x8シグナル, Gen 3.0, CPU側) SLOT_1: PCI-Express x8 (x4シグナル, Gen 3.0, PCH側)	
外形寸法		4Uラックマウント W429.5mm × D480mm × H177mm (突起物等を除く)	
重量		約20kg	
電源		ニブロン電源 400W (連続最大容量)/570W (ピーク容量)	1200W (80PLUS PLATINUM認証取得)
利用環境	入力電圧	AC90V~240V	
	温度	10°C~35°C	
	湿度	20%~80% RH (結露なきこと)	
保管環境	温度	-10°C~55°C	
	湿度	20%~80% RH (結露なきこと)	



HPCシステムズ株式会社 CTO事業部
〒108-0022 東京都港区海岸3-9-15 LOOP-X 8階
TEL: 03-5446-5535 / hpcs_sales@hpc.co.jp

embe.hpc.co.jp

会社名及び製品名は、当社及び各社の商標または登録商標です。価格、写真、仕様等は予告なく変更する場合があります。製品の色調は実際と異なる場合があります。Intel, インテル, Intel ロゴ, Intel Inside, Intel Inside ロゴ, Centrino, Centrino Inside, Intel Viiv, Intel Viiv ロゴ, Intel vPro, Intel vPro ロゴ, Celeron, Celeron Inside, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Core Inside, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, Viiv Inside, vPro Inside, Xeon, Xeon Inside は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation の商標です。AMD, AMD Radeon™, Radeon™ は、Advanced Micro Devices, Inc. の商標です。Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における商標または登録商標です。
2019年2月14日現在の内容です。